

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 6 月 30 日(30.06.2011)

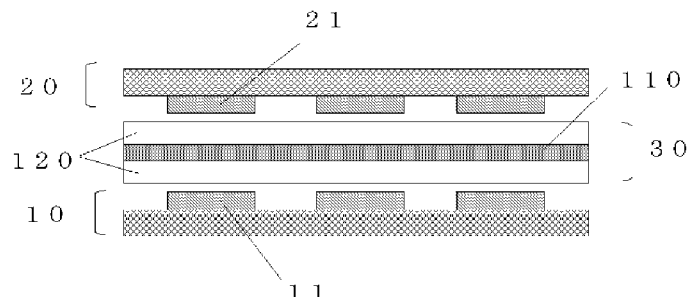
(10) 国際公開番号
WO 2011/077679 A1

- (51) 国際特許分類:
H05K 3/34 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
C09J 9/02 (2006.01) H01R 11/01 (2006.01)
H01B 5/02 (2006.01) H01R 43/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/007323
- (22) 国際出願日: 2010 年 12 月 17 日(17.12.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-292706 2009 年 12 月 24 日(24.12.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中馬 敏秋 (CHUMA, Toshiaki) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 鍵本 奉広 (KAGIMOTO, Tomohiro) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治 (HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田 7-9-2 五反田 T Gビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: CONDUCTIVE CONNECTION MATERIAL, ELECTRONIC COMPONENT PRODUCING METHOD, AND ELECTRONIC MEMBER AND ELECTRONIC COMPONENT WITH CONDUCTIVE CONNECTION MATERIAL

(54) 発明の名称: 導電接続材料、電子部品の製造方法、導電接続材料付き電子部材および電子部品

[図2]



(57) Abstract: Disclosed is a conductive connection material (30) used to form conductive portions on a plurality of terminals (11) of an electronic member having a substrate (10) and the terminals (11) provided on the substrate (10). The conductive connection material is provided with a metal layer (110) and resin layers (120) having a resin component and a filler. The conductive connection material is abutted with the plurality of terminals (11) and is heated, so that the metal layer (110) is agglutinated on each terminal (11), to form conductive portions on the plurality of terminals (11).

(57) 要約: 基板 (10) および基板 (10) 上に設けられた複数の端子 (11) を有する電子部材の、当該複数の端子 (11) 上に導電部を形成するために用いられる導電接続材料 (30) であって、金属層 (110) と、樹脂成分と充填剤とを有する樹脂層 (120) と、を備え、複数の端子 (11) 上に当接し、加熱することによって、金属層 (110) が各端子 (11) 上に凝集し、複数の端子 (11) 上に導電部を形成するように構成されている。

WO 2011/077679 A1